

決算説明会 (2012年6月期)

2012年8月14日

株式会社 アルバック

◆将来見通しに関する記述についての注意事項

このプレゼンテーション資料で述べられている将来の当社に関する見通しは、現時点で知りうる情報をもとに作成されたものです。当社グループのお客様であるフラットパネルディスプレイ(FPD)・半導体・太陽電池・電子部品などの業界は技術革新のスピードが大変速く、競争の激しい業界です。

また、世界経済、為替レートの変動、FPD・半導体・電子部品・原材料などの市況、設備投資の動向など、当社グループの業績に直接的・間接的に影響を与える様々な外部要因があります。したがって、実際の売上高および利益は、このプレゼンテーション資料に記載されている予想数値とは大きく異なる可能性があることをご承知おきください。

◆本資料における表示方法について

数値： 単位未満四捨五入

比率： 百万円単位で計算後、単位未満四捨五入

会計期間の表現：

2Q(累計)：第2四半期連結累計期間

2Q : 第2四半期連結会計期間

アジェンダ

事業構造改革と変革方針

代表取締役会長

諏訪秀則

2012年6月期連結業績概要

取締役執行役員

経理部長 佐藤孔史

種類株の発行について

取締役執行役員

財務部長 中村孝男

2013年6月期連結業績予想

執行役員社長 小日向久治

今後の事業戦略について

執行役員社長 小日向久治

質疑応答

事業構造改革第1弾

■2012年6月期実施の構造改革第1弾は計画通り進捗

- ▶ 人員削減 計画を上回る 879名(計画700名)
- ▶ 固定資産の除却・減損 計120億円(計画112億円)
 - ◆ 事業の見直しと絞り込みを実施
- ▶ 固定費削減 159億円(計画155億円)



損益分岐点は2,000億円台から1,600億円台へ
引き下げ収益力アップ

◆メイン銀行の株式会社みずほ銀行様をはじめ株式会社三井住友銀行様、日本生命保険相互会社様など主要取引金融機関様からは、当社「事業構造改革プラン」に対するご理解と金融面でのご協力を得ております

経営体制刷新

■経営体制刷新にて事業戦略・構造改革実行を加速

- ▶ グループ内で事業改善・実績もある小日向社長が経営の執行をリード
- ▶ 事業構造改革については引き続き諏訪がリードし、責任を全う
- ▶ 加えて、執行役員制導入により執行のスピード・アップを図り、業績の早期回復を目指す
 - ◆ 取締役 18名から9名へ

資本増強

■資本増強により長期的成長にフォーカス

- ▶ 事業構造改革計画発表時は、既存株主への影響も踏まえ、株式による資本増強につき回避を想定
- ▶ 一方で、財務基盤の早期強化(時間の先取り)を通じて、事業構造改革による財務体力低下(純資産508億円毀損)の早期解消が、今後の長期成長戦略達成において必須と判断
- ▶ 種類株式の発行は、既存株主への影響を限定しつつ、長期的な株主価値向上に寄与するものと思料
 - ◆ 株式希薄化を極力避けるストラクチャーで調達
 - ◆ 合理的に可能な限り、全額現金償還により普通株式転換を回避する意向

体質改善

■ 構造改革第2弾で中長期的な体質改善を行う

▶ 変革方針

- ◆ 収益力の向上(3S+1D運動の徹底)
- ◆ 予測精度の向上と変化に対応できる組織
- ◆ 連結各社の自立と小さな本社
- ◆ 利益率を重視した迅速な営業活動
- ◆ 業績に早期貢献する開発の推進
- ◆ 従業員のレベルアップと少数精鋭の組織
- ◆ 居心地の良い組織から、真に働きがいのある会社へ

新社長の略歴



小日向久治

氏名 小日向久治 (おびなたひさはる)
 生年月日 1949年9月25日
 最終学歴 新潟大学 理学部 物理学科
 略歴

- 1972年 日本真空技術(株)(現(株)アルバック)入社
(電子機器・半導体分野の蒸着、スパッタ装置
検査担当)
- 1975年 初の米国駐在員(FSE)として3年間駐在
- 1978年 帰国、半導体事業部スパッタ装置技術担当
- 1988年 半導体事業部長
- 1990年 取締役
- 1996年 半導体事業本部長
- 1998年 常務取締役
- 2000年 米国法人社長としてボストンに6年間駐在
- 2006年 帰国、アルバックテクノ(株)社長就任
- 2012年 (株)アルバック 執行役員社長に就任

(9月27日株主総会後の取締役会で代表取締役社長執行役員に就任予定)

アジェンダ

事業構造改革と変革方針

代表取締役会長

諏訪秀則

2012年6月期連結業績概要

取締役執行役員

経理部長 佐藤孔史

種類株の発行について

取締役執行役員

財務部長 中村孝男

2013年6月期連結業績予想

執行役員社長 小日向久治

今後の事業戦略について

執行役員社長 小日向久治

質疑応答

2012/6期の状況

- 事業環境
 - ▶ 超円高が継続
 - ▶ 欧州債務危機が長期化し、中国など輸出が滞り、成長が鈍る
- ポジティブ要因
 - ▶ スマートフォン関連ビジネスが堅調を維持
 - ◆ FPD関連は、低温ポリシリコンTFTやOLEDなどの中小型パネルが好調を維持
- ネガティブ要因
 - ▶ 大型FPD関連は引き続き低調
 - ▶ メモリ(DRAM、NAND)関連も低調
 - ▶ PV関連は、高効率PVのみ投資。薄膜Siは失速。
- 将来の成長のために、構造改革を断行
 - ▶ 創立以来初的大幅な構造改革を実施し、スリム化を図る。
 - ◆ 人員削減、固定資産減損、たな卸資産評価減など
 - ▶ 損益分岐点を大幅に引き下げ

2012/6期業績

■売上高は予想値を下回ったものの、コスト削減により利益面で予想を上回る

受注高は、大型FPD関連、メモリ関連の計画延期やPV関連が低迷。前期比大幅減。

売上高は、OLED、中小型LCDなどが寄与するが前期比大幅減。利益は、上期はコストダウンや固定費削減などで黒字が確保できたものの、下期はOLED、タッチパネル用装置の追加原価が大幅に増加したこと、構造改革に伴う費用などで、大幅な赤字計上。

【単位：億円】

	11/6期	12/6期	
		予想 (4/26発表)	実績
受注高	2,359	1,650 (-30%)	1,522 (-35%)
受注残高	1,109		650
売上高	2,320	2,130 (-8%)	1,968 (-15%)
営業利益	19	-74	-64
率	0.8%	-3.5%	-3.2%
経常利益	14	-75	-65
率	0.6%	-3.5%	-3.3%
特別利益	2	2	2
特別損失		280	274
税金費用		156	156
少数株主損益		6	7
当期純利益	-87	-516	-500

売上高 予想対比 ▲162億円
(主な要因は、FPD関連の期ずれ、材料は客先減産などによる)

営業利益 予想対比 +10億円
(主な要因は、販管費の削減による)

特別損失 予想対比 ▲6億円
(主な要因は「その他(子会社清算損等)」が予想を下回ったため)

棚卸資産評価損・除却損	85億円
固定資産除却損	61億円
減損損失	59億円
特別加算退職金等	47億円
その他	21億円

繰延税金資産取り崩し 135億円

【()内は前年同期比、増減率、百万円単位で計算後、単位未満四捨五入】

品目別売上高の実績

■欧州債務危機の影響などでFPD中心に相次ぐ投資計画の延期。加えて客先の減産の影響で売上予想未達

品目別の差異(予想比)

【単位:億円】

2011/6期		2012/6期			
セグメント及び品目	実績	予想 (4/26発表)	実績		主な差異の要因
			売上高	増減率	
真空機器事業	1,900	1,725	1,599	-7%	
FPD製造装置	937	846	795	-6%	OLEDやLTPS関連の売上時期の期ずれなどによる
PV製造装置	163	99	67	-32%	化合物系などの投資計画延期などによる
半導体及び電子部品製造装置	335	312	292	-6%	NANDフラッシュ、LED関連の投資計画延期による
コンポーネント	271	230	222	-4%	LCD向けポンプの投資計画延期など
一般産業用装置	196	239	223	-7%	客先計画延期などによる
真空応用事業	420	405	369	-9%	
材料・部材	200	175	159	-9%	LCD大幅減産による
その他	220	230	210	-9%	分析関連で投資計画延期などによる
合計	2,320	2,130	1,968	-8%	

【記載された金額は四捨五入しておりますので各項目の合計値が一致しない場合があります。】

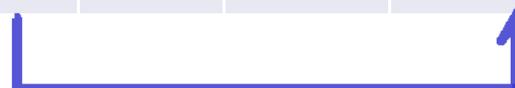
構造改革の進捗

■第1弾(見直し、スリム化)は予定通り完了

特別損失項目

【単位:億円】

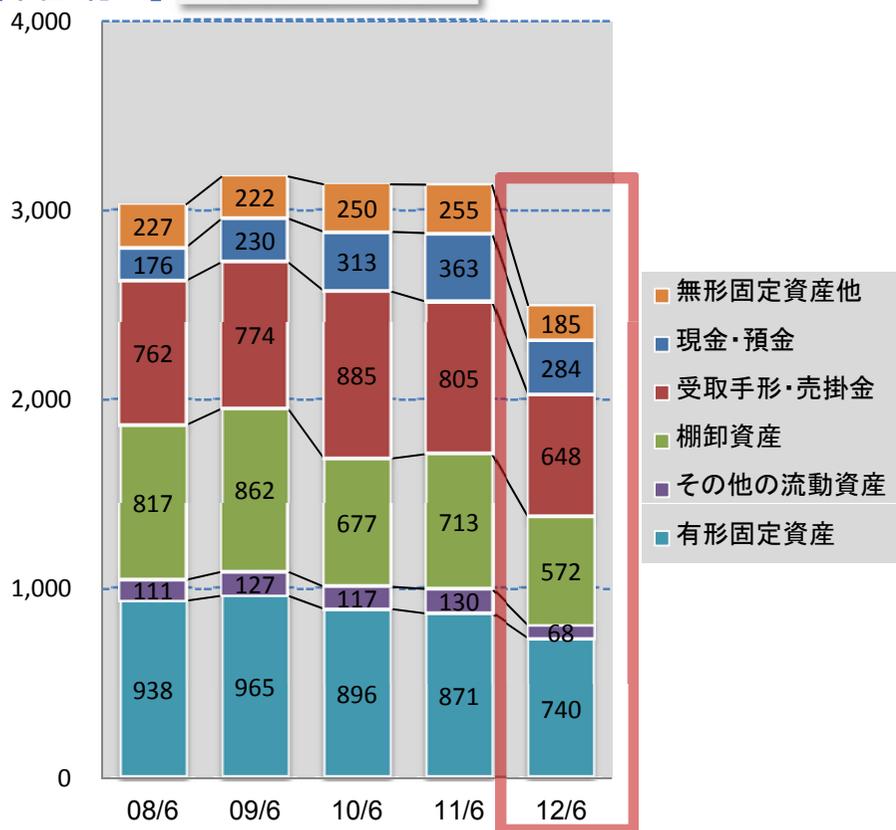
処理項目	予想 (4/26発表)	3Q	4Q	合計	状況
棚卸資産圧縮	85	85	0	85	完了
固定資産除却	62	57	4	61	完了
減損	50	42	17	59	完了
希望退職 (当社及びグループ会社)	49	—	47	47	完了
その他	34	3	19	21	完了
合計	280	187	87	274	



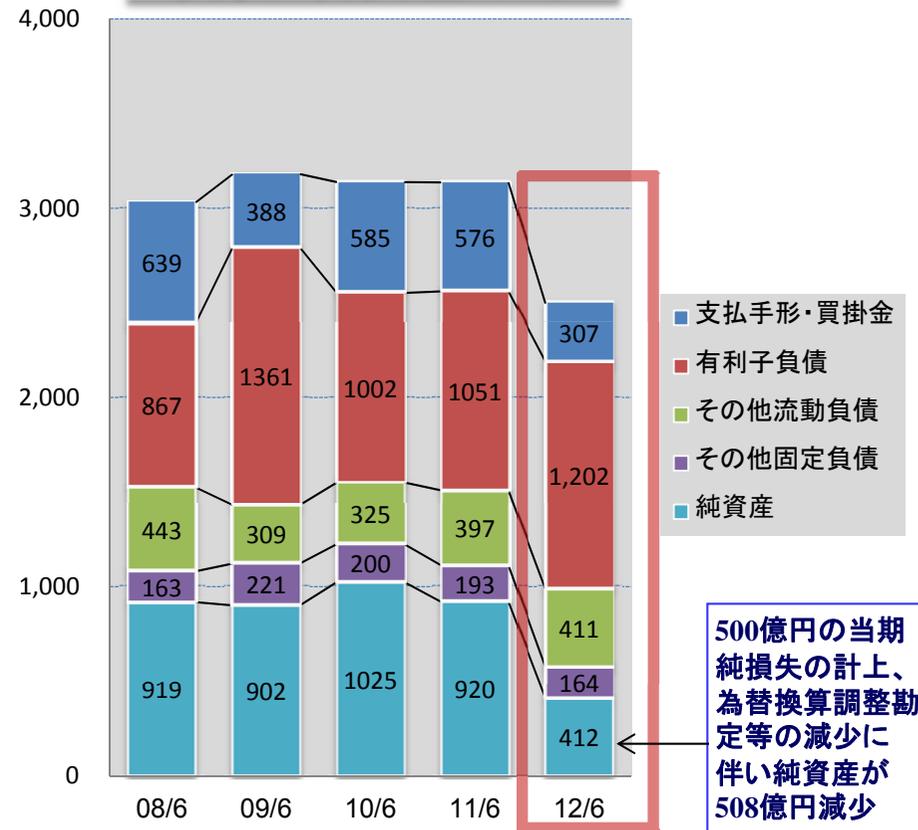
連結貸借対照表

■減損など固定資産、たな卸資産が大幅減少し、純資産が毀損

【単位：億円】 資産の部



負債・純資産の部



【記載された金額は四捨五入しておりますので各項目の合計値が一致しない場合があります。】

アジェンダ

事業構造改革と変革方針

代表取締役会長

諏訪秀則

2012年6月期連結業績概要

取締役執行役員

経理部長 佐藤孔史

種類株の発行について

取締役執行役員

財務部長 中村孝男

2013年6月期連結業績予想

執行役員社長 小日向久治

今後の事業戦略について

執行役員社長 小日向久治

質疑応答

種類株式発行のキーポイント

■ 今次資本増強は長期的な株主価値向上に寄与するものと思料

発行総額150億円の第3者割当による種類株発行
引受人 ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ
第壹号投資事業有限責任組合

- ▶ 財務基盤の早期強化(「時間の先取り」)
- ▶ 既存株主にも十分配慮し、普通株式転換による株式希薄化を最小限に抑制する設計
- ▶ 合理的に可能な限り、全額現金償還により普通株式転換を回避する意向

種類株式の発行について

目的	<p>▶ 財務基盤の早期強化(時間の先取り)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業構造改革プラン実行に伴い純資産を大きく毀損 ⇒資本増強により3年後の財務体質(自己資本比率)を早期に実現
	<p>▶ 必要資金の前倒し確保</p> <ul style="list-style-type: none"> ・希望退職金等の支払に見合う借入金の返済 ・研究開発のスピードを早めるため、前倒しで長期的資金の確保が有効

「時間の先取り」

	2012/6 期末	2013/末 (発行後)	2015/6期末 (償還後)	2015/6期末 (当初計画)
自己資本比率	14.8%	20.6%	22.1%	22.9%
ネットD/Eレシオ	2.48倍	0.87倍	0.74倍	0.75倍

注)上記予想数値は、あくまでも中期の予想をイメージしたもので確約された数値ではありません。

種類株式の発行について

■特徴

▶当初は低めの配当率

- ◆3.5%(当初約3年間) 4年目以降4%

▶優先株式(償還は現金でも一部は普通株式でも可能)

- ◆普通株式転換による希薄化を最小限に抑制する工夫をしている
- ◆合理的に可能な限り、全額現金償還により普通株式転換を回避する意向

▶現金償還 ⇒ 弊社の取得権(コール)がJISの取得請求権(プット)に優先

- ◆弊社の取得権(コール):全額現金償還
- ◆JISの取得請求権(プット):プレミアム償還部分のみ普通株式転換可能

▶希薄化の抑制

- ◆JISのプット権に上限設定 (3年目50億円、4年目累計100億円)
⇒ プット権の行使に伴い、プレミアム部分の普通株式転換が起きたとしても急激に希薄化するのではなく段階的。

▶償還について

- ◆本株式の払込金額(元本)等は減資の手続きで配当可能財源に計上
⇒ 利益の積み上げとともに償還原資は十分に確保されている
⇒ 全額が普通株式に転換される可能性は限定的
- ◆減資の手続きは十分な配当可能財源を確保するためであり
既存株主様の利益を損なうものではない

15/6期までのキャッシュ・フローのイメージ

■ 営業CF (3年間累計492億円) にて種類株式の全額現金償還は十分可能

2013/6期予想		2014/6期予想		2015/6期予想	
当期純利益	23	当期純利益	80	当期純利益	127
減価償却費	87	減価償却費	86	減価償却費	84
運転資金	57	運転資金	△27	運転資金	△41
その他	△15	その他	18	その他	13
営業CF	152	営業CF	157	営業CF	183
投資CF	66	投資CF	61	投資CF	66

3年間 累計営業CF 492億円
3年間 累計投資CF 193億円

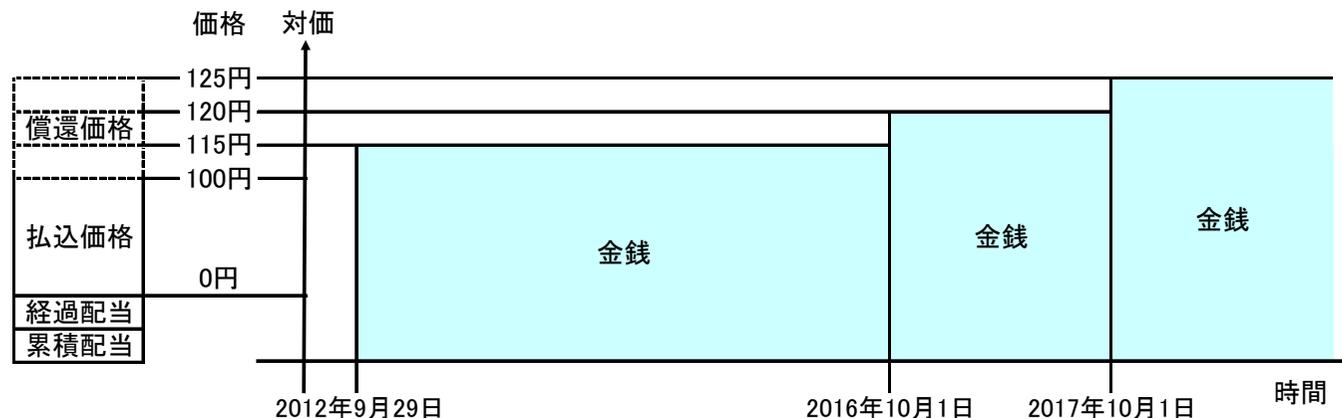
- ・今後3年間の営業CF (3年間累計492億円) にて、構造改革計画上の設備投資 (投資CF3年間累計193億円) および種類株式償還資金等を十分に賄える計画

注) 上記予想数値は、あくまでも中期の予想をイメージしたもので確約された数値ではありません。

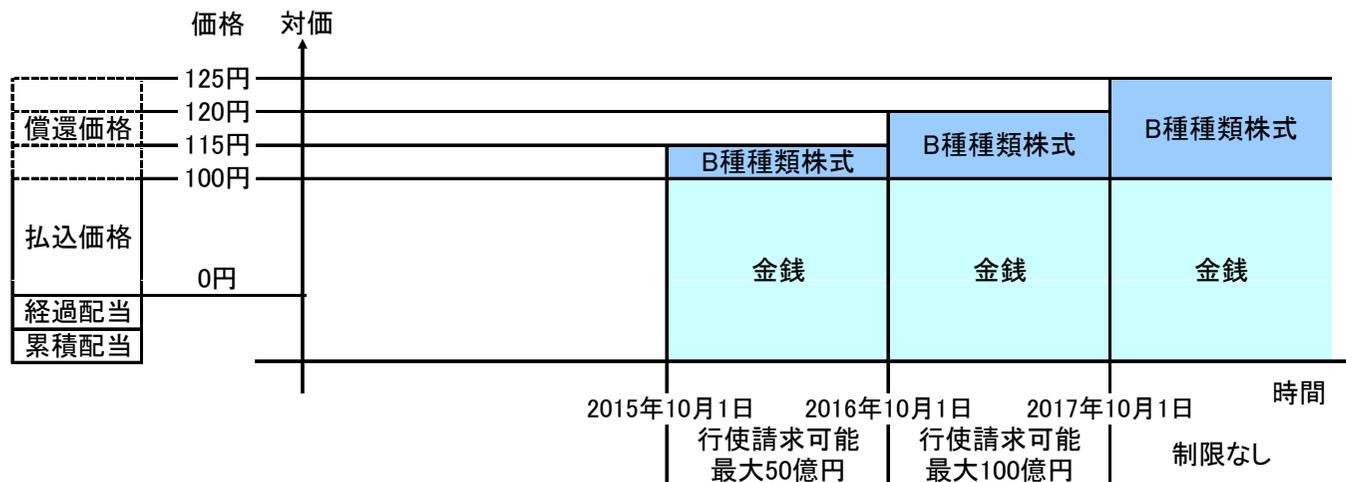
種類株式の発行について

- 弊社コールは全額現金償還
- JISプットによるB種（普通株式転換可能）発行はプレミアム償還部分に限定

弊社コール
(全額現金)



JISプット
(現金+B種)



アジェンダ

事業構造改革と変革方針

代表取締役会長

諏訪秀則

2012年6月期連結業績概要

取締役執行役員

経理部長 佐藤孔史

種類株の発行について

取締役執行役員

財務部長 中村孝男

2013年6月期連結業績予想

執行役員社長 小日向久治

今後の事業戦略について

執行役員社長 小日向久治

質疑応答

2013/6期業績予想

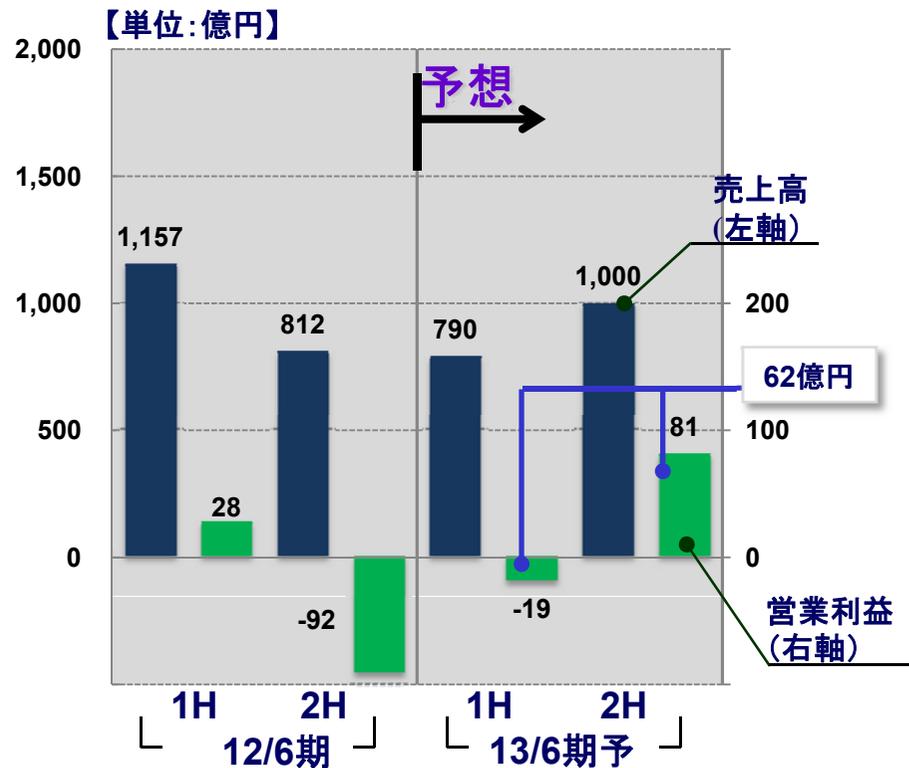
■ 損益分岐点(1600億円台)を引き下げ、通期で営業利益62億円を見込む

受注高は、中小型のFPD投資を日本、中国などで見込む。半導体(メモリ)は下期に回復を見込む。
 売上高は、FPDの前期の受注が大幅に減少した影響などで、減収を見込む。営業利益は、上期は損益分岐点を大幅に引き下げたが、売上高の減少で、赤字を予想。下期は売上高が増え、黒字転換。

【単位:億円】

	12/6期 実績	13/6期予	
		2Q(累計)	通期
受注高	1,522 (-35%)	1,037 (+26%)	1,960 (+29%)
受注残高	650	897	820
売上高	1,968 (-15%)	790 (-32%)	1,790 (-9%)
営業利益	-64	-19	62
率	-3.2%	-2.5%	3.5%
経常利益	-65	-30	46
率	-3.3%	-3.7%	2.6%
当期純利益	-500	-36	23

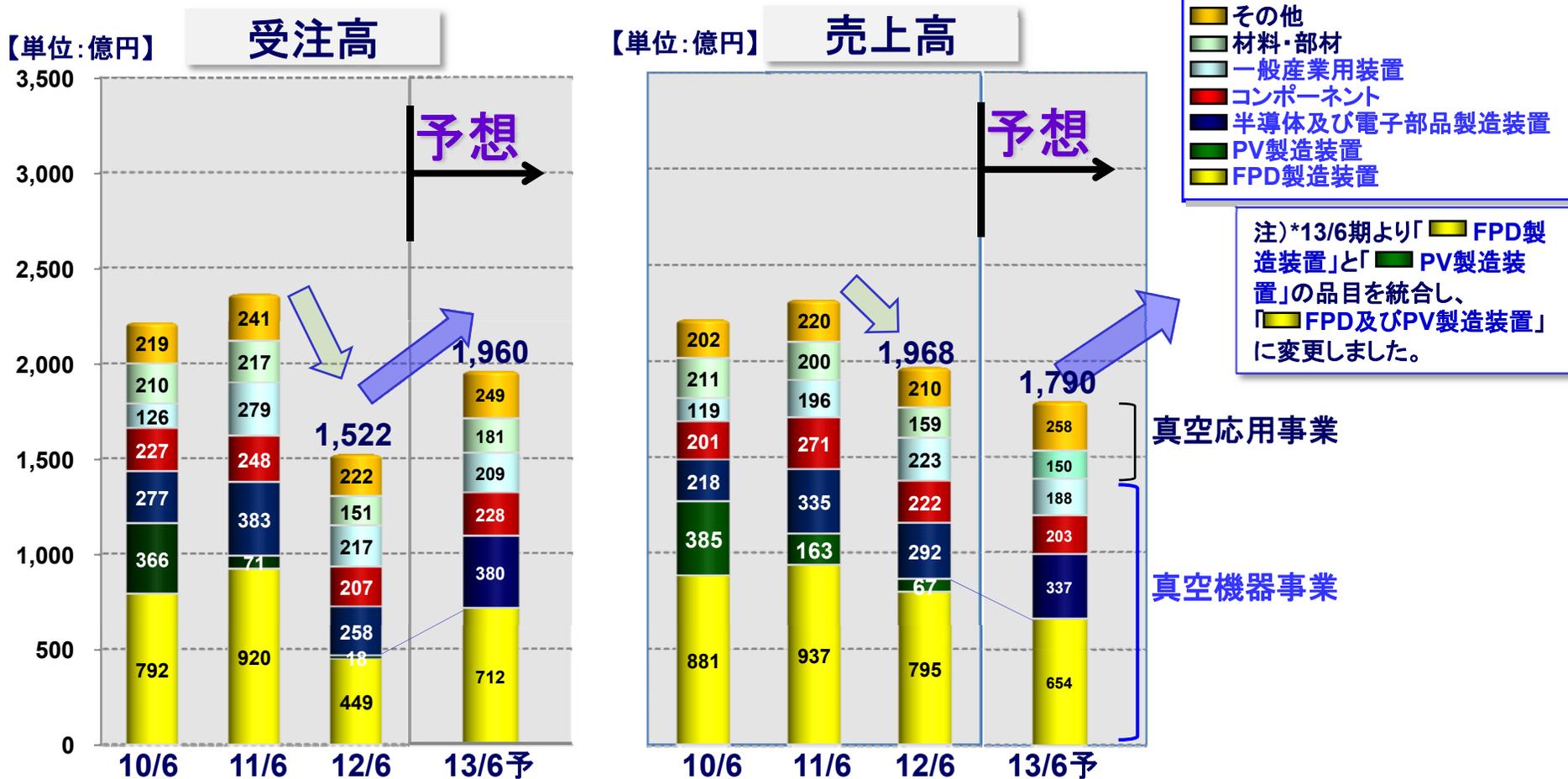
売上高と営業利益の推移(半期毎)



【()内は前年同期比、増減率、百万円単位で計算後、単位未満四捨五入】

品目別受注高/売上高実績・予想

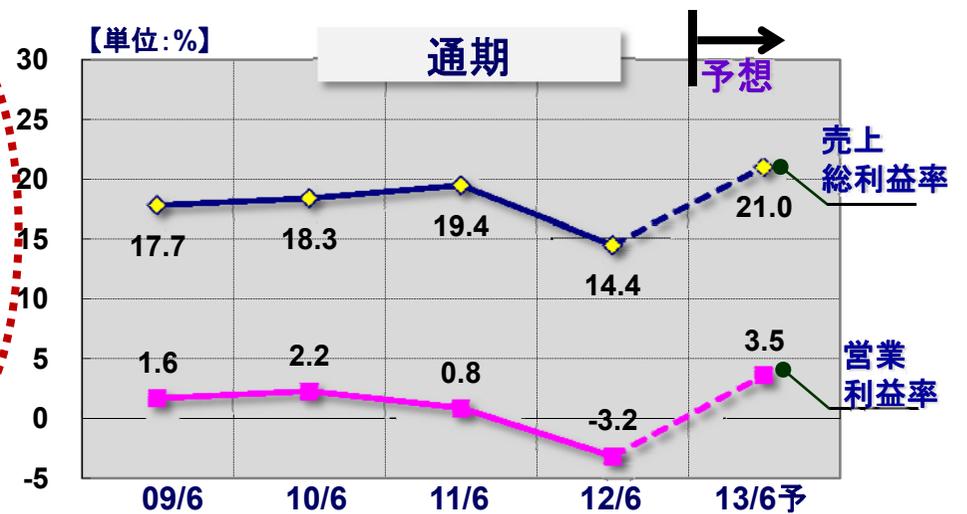
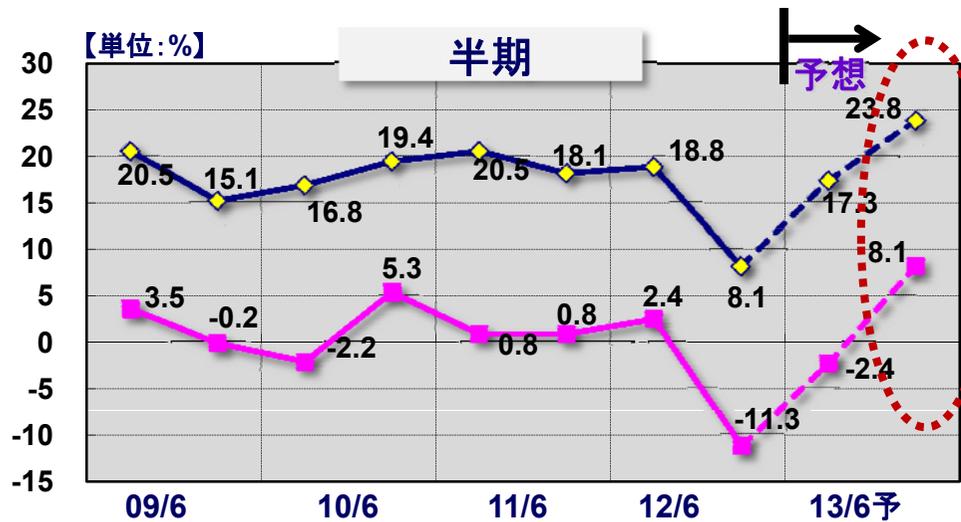
■12/6期の受注が大幅に落ち込んだ結果、13/6期の売上が減少するも、13/6期の受注は順調に回復することから、14/6期の売上は増加へ



【記載された金額は四捨五入しておりますので各項目の合計値が一致しない場合があります。】

利益率の推移・予想

■上期は赤字を予想するが、下期は売上の回復や構造改革効果がフルに効いてくることから、半期ベースで上場来最高水準へ

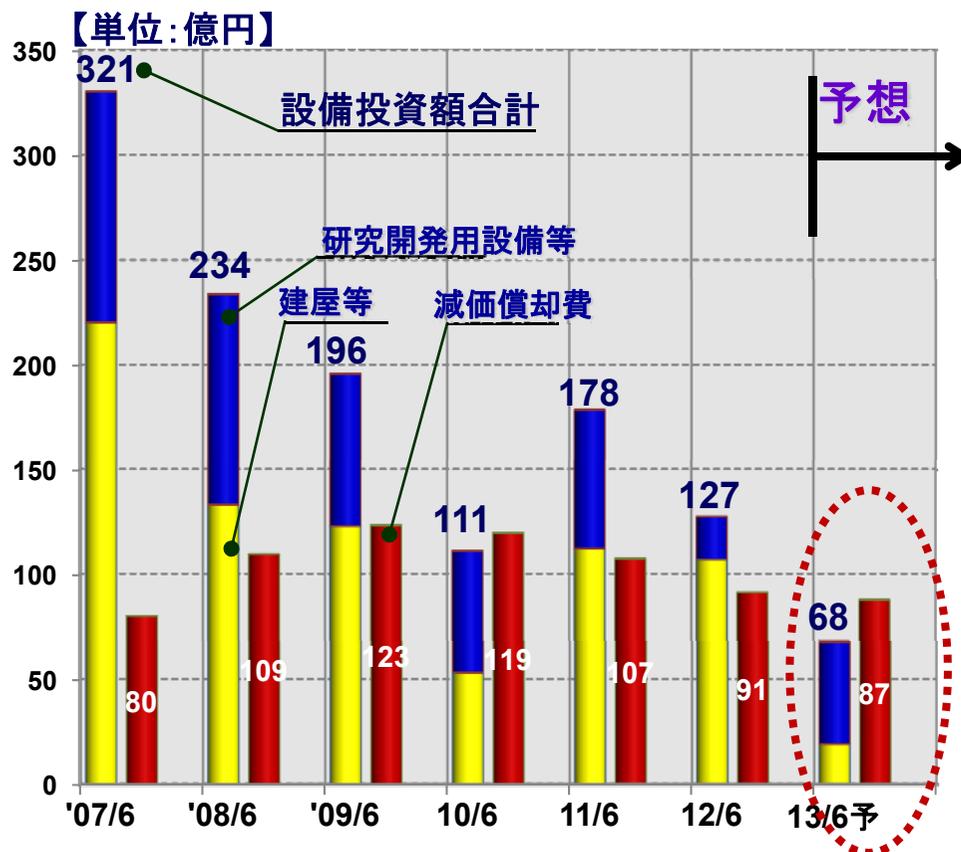


【小数点以下第2位は四捨五入】

設備投資、減価償却費、研究開発費の推移・予想

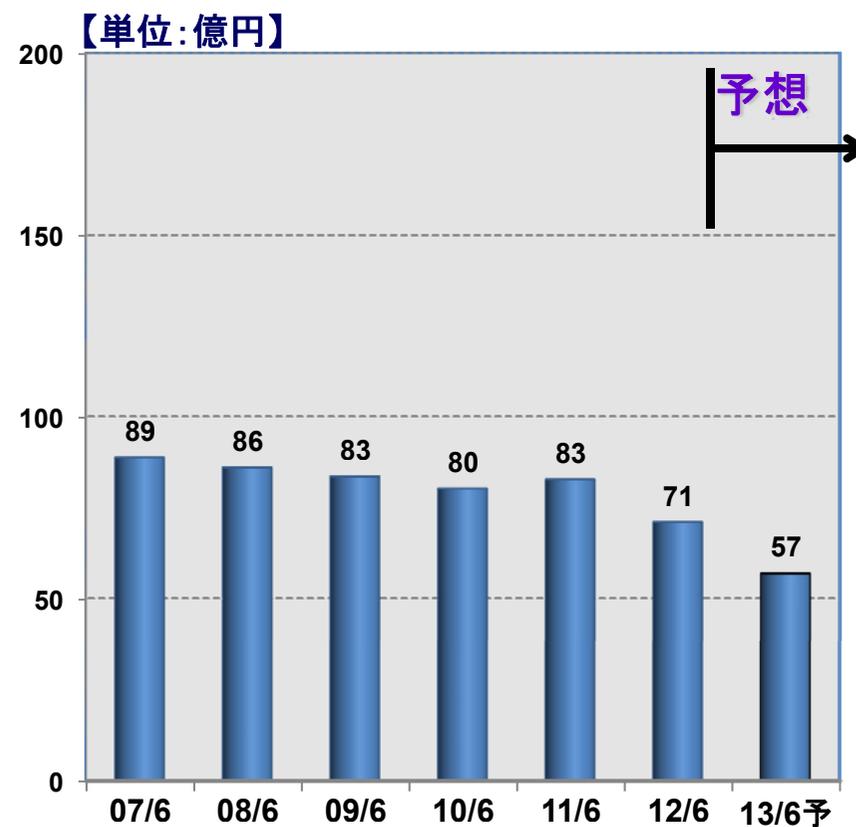
■構造改革の一環で、開発の適切な選択と集中を実施。設備投資を適正な水準に抑えた結果、減価償却費内に。研究開発費は今後の成長を支えるには十分なレベルを確保

設備投資及び減価償却費の推移・予想



【単位未満は四捨五入】

研究開発費の推移・予想



アジェンダ

事業構造改革と変革方針

代表取締役会長

諏訪秀則

2012年6月期連結業績概要

取締役執行役員

経理部長 佐藤孔史

種類株の発行について

取締役執行役員

財務部長 中村孝男

2013年6月期連結業績予想

執行役員社長 小日向久治

今後の事業戦略について

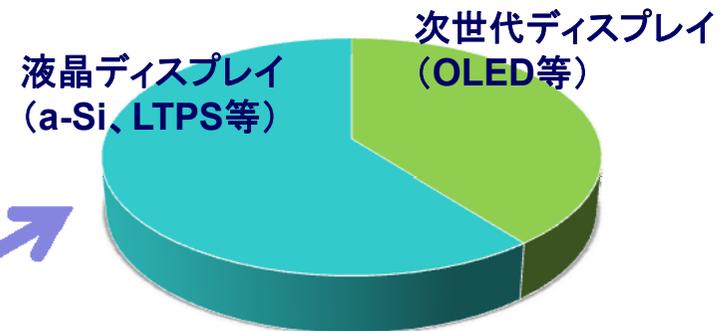
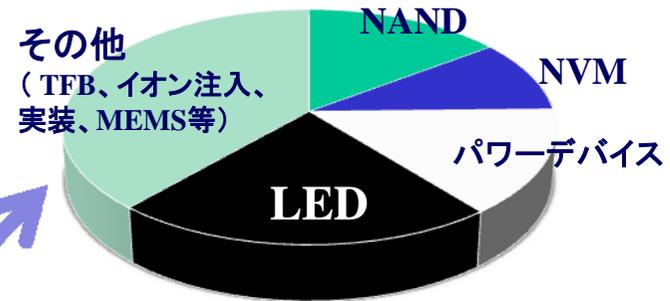
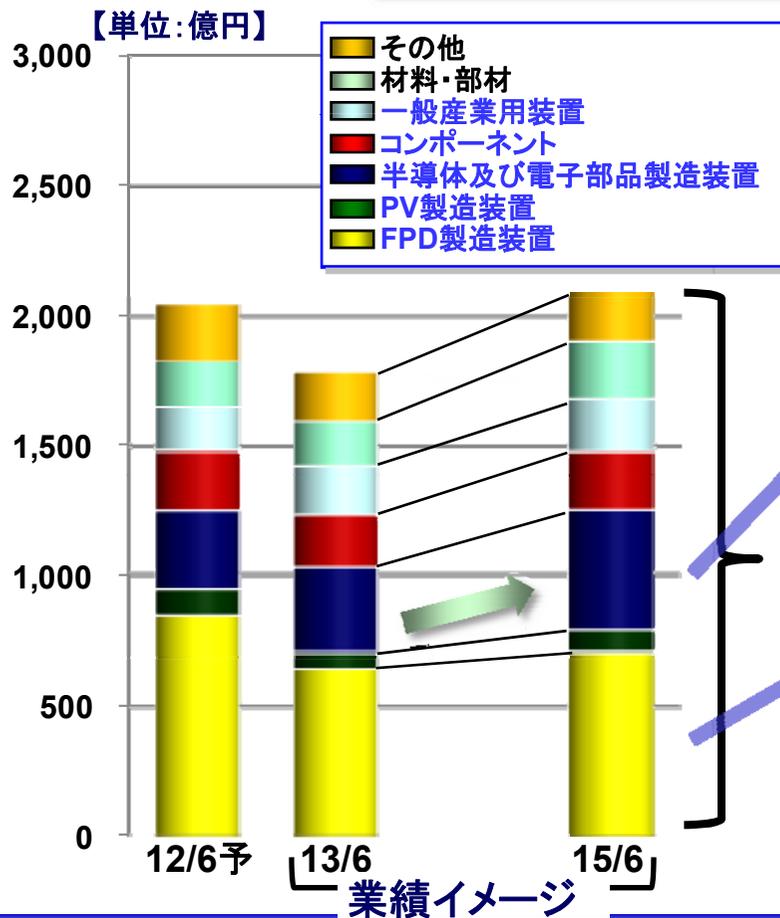
執行役員社長 小日向久治

質疑応答

15/6期売上高のイメージ

■ 今後は、半導体・電子部品では、LED、パワーデバイス、NVMなどの市場が拡大。
FPDではOLEDが成長を牽引。

品目別売上高イメージ



15/6期業績イメージ

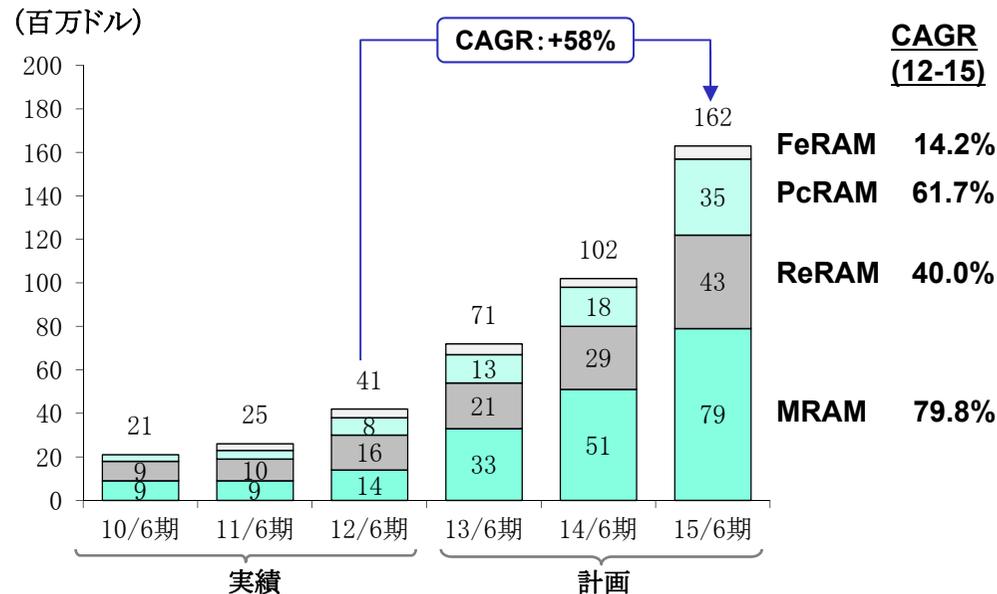
・売上高	2,100億円
・営業利益	170億円 (8%)

注) 上記予想数値は、あくまでも中期の予想をイメージしたもので
確約された数値ではありません。

戦略商品の紹介: 不揮発性メモリ用製造装置

■ポストNAND/DRAMとして不揮発性メモリデバイスが成長する見通し

不揮発性メモリ装置市場



不揮発性メモリ種類別概要

MRAM「磁気抵抗メモリ」: 記録媒体にHDD等と同様の磁性体を用いたメモリ
 ReRAM「抵抗変化型メモリ」: 電気抵抗の変化を利用したメモリ
 PcRAM「相変化メモリ」: 相結晶、アモルファス相の切替を利用したメモリ
 FeRAM「強誘電体メモリ」: 強誘電体の履歴現象を利用したメモリ

出所: 装置導入状況を元に当社予測

不揮発性メモリ市場動向

- ポストNAND/DRAMデバイスとして、さらなる省エネ化・データ性能向上に向けて、不揮発性メモリの成長が見込まれる
- デバイスメーカーごとに推進している方式が異なっている
- 当面は研究開発投資に向けた設備投資需要であり、米国にある工場、韓国にある工場等、各メーカーの旗艦工場での設備投資が見込まれる

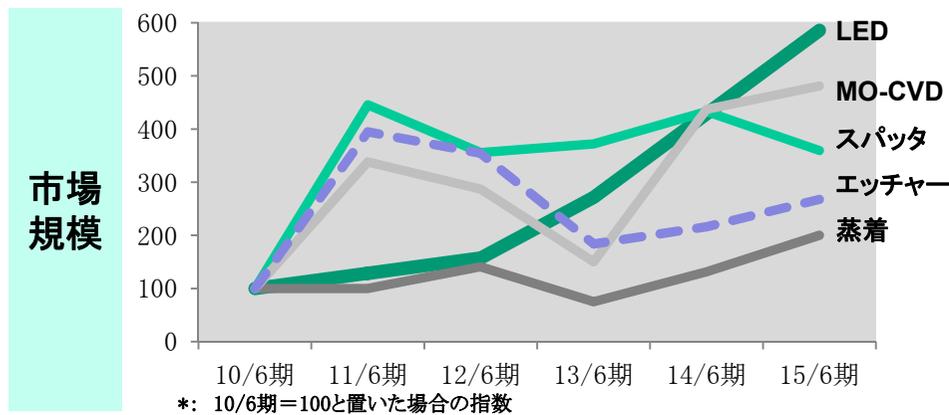


スパッタおよびCVD成膜装置
ENTRON, EX, EX-2

戦略商品の紹介: LED用製造装置

■ LED装置市場は、13/6期には過去2年の過剰投資の反動で落ち込むが、以降はLED市場の急拡大に伴い回復。

市場規模、アルバック(連結)推移



事業環境

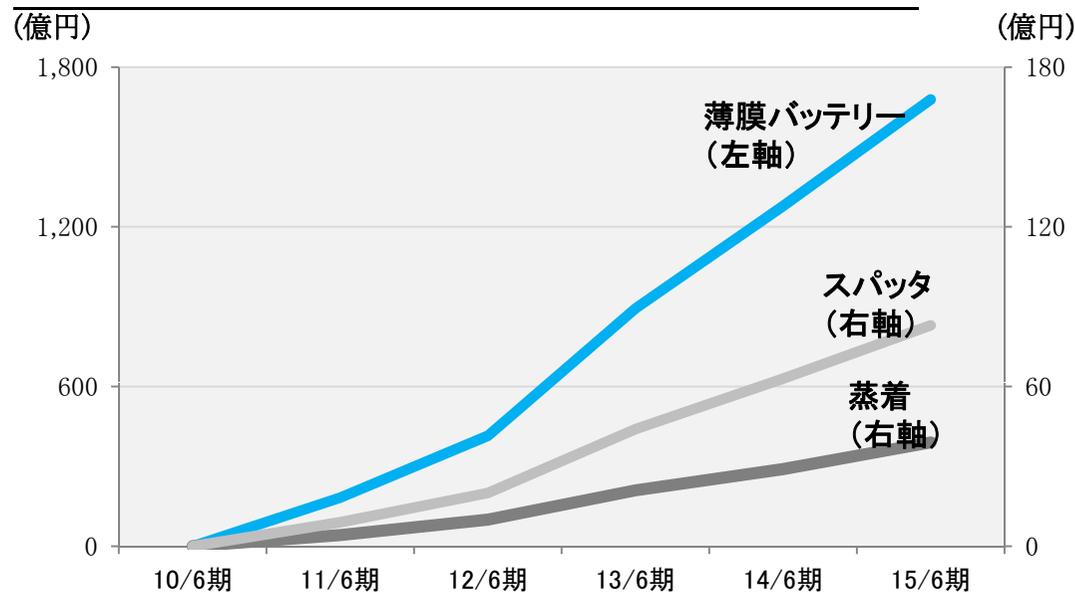
- LED :LED TV用中心からLED照明用中心へ変化し、再度拡大
 - 蒸着 :主に蒸着を使用するLED韓国・中国勢の台頭により海外(アジア)を中心に市場は倍増
 - スパッタ :主にスパッタを使用するLED国内勢が、韓国・中国勢の台頭によりシェアを落とすマイナス影響が想定される一方、13/6期以降、新規スパッタ工程が追加されるプラス影響もあり、市場は横這いの見通し
 - MO-CVD、エッチャー : 12/6期までの中国での過剰設備投資により余剰装置となり、設備投資が再開されるのは14/6期以降

出所: IMSリサーチ、半導体産業新聞より、アルバック予測

戦略商品の紹介：新領域デバイス用

- 新領域デバイス（薄膜バッテリーなど）用装置市場規模は、今後大きな市場に成長することが期待されている。

薄膜バッテリー用市場規模（金額）



- 薄膜リチウム二次電池の特徴
 - 極薄&フレキシブル(厚さ0.1 mm以下)
 - 環境親和性
 - 安全性(液漏れ、発熱、発火無し)
 - デザイン自由度
 - 超長寿命(10年以上保持)

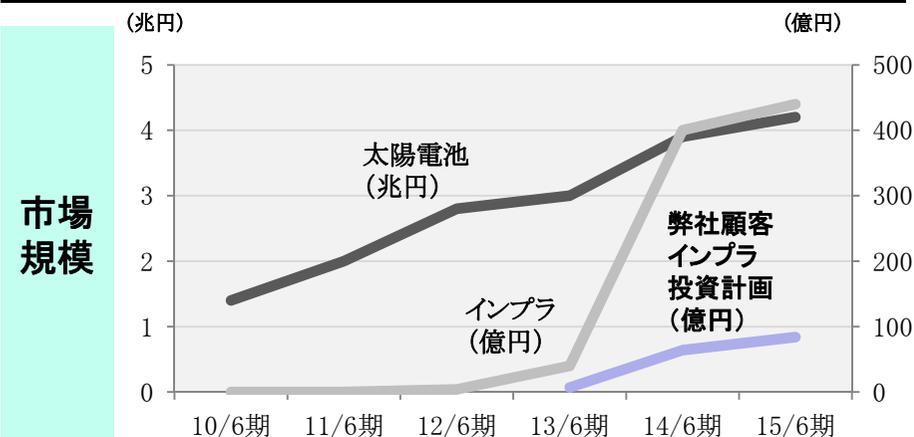


出所： 富士経済、U.S. National Statistical Review and Forecast, Ducker

戦略商品の紹介: 太陽電池用イオン注入装置

- 太陽電池用装置市場では、イオン注入が次世代結晶系の変換効率を大幅アップさせる新規プロセスとして急拡大する見通し

市場規模、アルバック(連結)推移



出所: 富士キメラ総研、アルバック予測



事業環境

太陽電池

- 変換効率が高く価格が急激に下がっている結晶系を中心に拡大
- 薄膜系及び化合物系は、現時点、変換効率及び価格競争力で結晶系に劣るため当面の伸びは限定的も、性能向上しつつある化合物は先行き伸びる見通し

市場環境

イオン注入装置

- 既存の太陽電池製造ラインに本装置を導入することで、太陽電池セルの変換効率の改善が可能

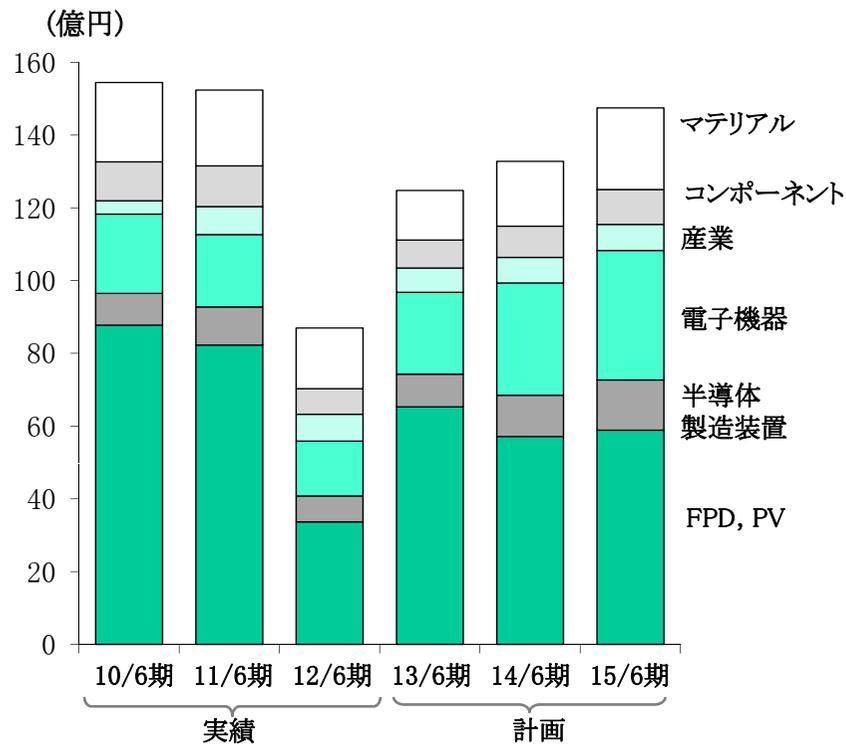
全体受注イメージ

■半導体製造装置、電子機器、マテリアル中心にトップラインを伸ばす。
FPD、PVはほぼ横ばいを想定

用途市場別受注シナリオ(単体ベース)

トレンド

前提条件



マテリアル

- LCD用ターゲット受注は基本的にLCD面積市場に連動と見込むが、AI配線からCu配線へ(MoからMo合金へ)のシフト及びIGZO市場拡大、ITO挽回施策も想定
- 半導体用ターゲット受注は基本的にウェーハ面積市場に連動して拡大。

電子機器

- 用途市場別の成長領域はグリーンビジネス周りであり、LED用、結晶系太陽電池用、パワーデバイス用が主

半導体製造装置

- 用途市場別には、NAND/DRAM、不揮発性メモリデバイス向け製造装置の受注が中心

FPD, PV

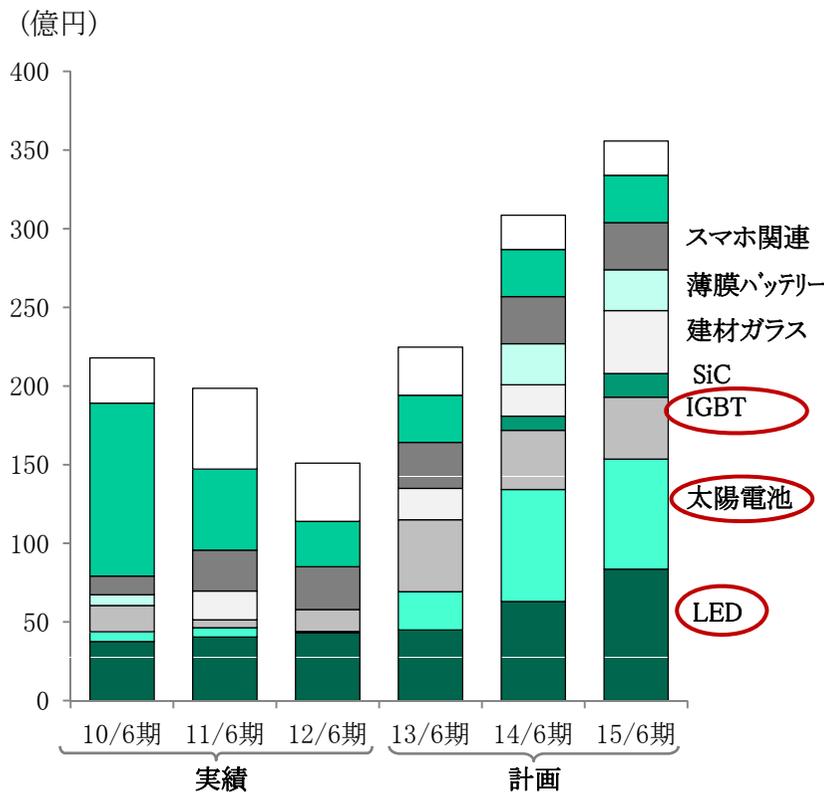
- 用と市場別には、IGZOとOLEDが成長の牽引役になり、a-Si、LTPSの成長は鈍化。

注)上記予想数値は、あくまでも中期の予想をイメージしたもので確約された数値ではありません。

電子機器製造装置の受注イメージ

■用途別では、LED用、結晶系太陽電池用、パワーデバイス用などグリーンエネルギー関連分野の成長が期待される

用途市場別受注シナリオ(単体ベース)



トレンド



前提条件

新領域デバイス(SiC、建材ガラス、薄膜バッテリー)

- 市場拡大ペースは保守的に見込むが、各市場の先行プレーヤーと緊密に連携することにより、市場でのトップポジションを確保

パワーデバイス(IGBT)用

- IGBTトップメーカー(日系)のシェア拡大投資に追随し拡大
- 中国顧客へは、日本での実績装置の要求に応じて引き合い増加

太陽電池用

- イオン注入装置が次世代結晶系PVの変換効率を大幅アップ(18%→23%)させる新規プロセスとして急拡大の見通しにあり、かつ、当社が独自技術を持つイオン注入を中心とした受注を企図
- 数社で評価中。一番引き合いが強い顧客の案件を織込む

LED用

- スパッタ、蒸着では、LEDトップメーカー(日系、韓国系)の1stベンダーとして強固なポジションを築いており、顧客の成長に伴い拡大

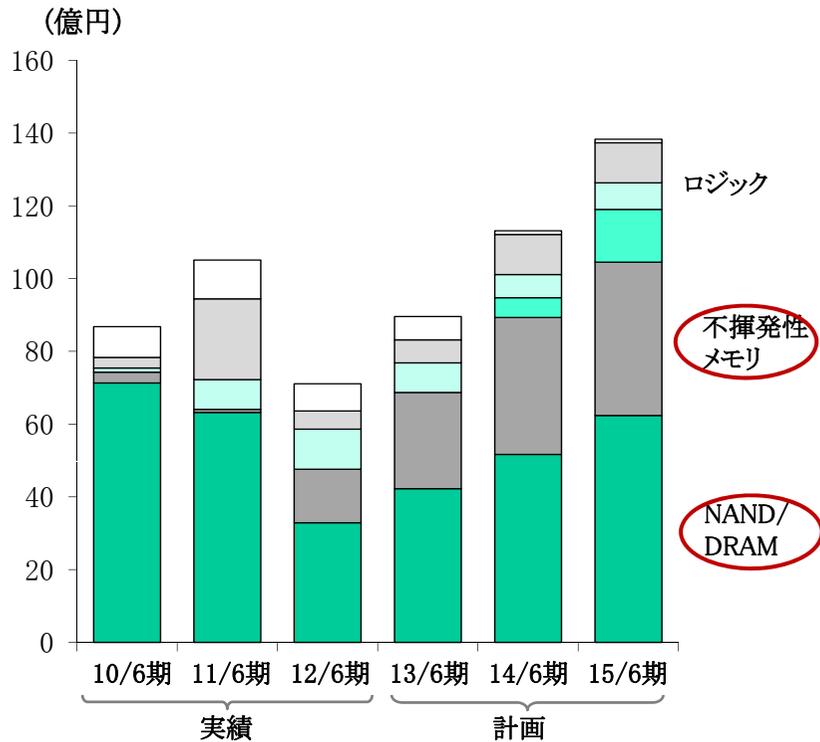
注)上記予想数値は、あくまでも中期の予想をイメージしたもので確約された数値ではありません。

半導体製造装置の受注イメージ

■用途市場別には、NAND/DRAM、不揮発性メモリデバイス、及びロジック向け製造装置の受注の伸びを見込む

用途市場別受注シナリオ(単体ベース) トレンド

前提条件



ロジック

- 顧客企業と共同で、次世代半導体デバイスの製造装置を開発中。開発完了後、共同開発メーカーのアライアンス先の次世代デバイス装置需要を取り込み

不揮発性メモリ

- ポストNAND/DRAMデバイスとしての新プロセス開発に向けた研究開発投資需要を、主要顧客各社との共同開発により取り込み

NAND/DRAM

- 主要顧客における工場新規設置に伴う設備投資需要により拡大

注)上記予想数値は、あくまでも中期の予想をイメージしたもので確約された数値ではありません。

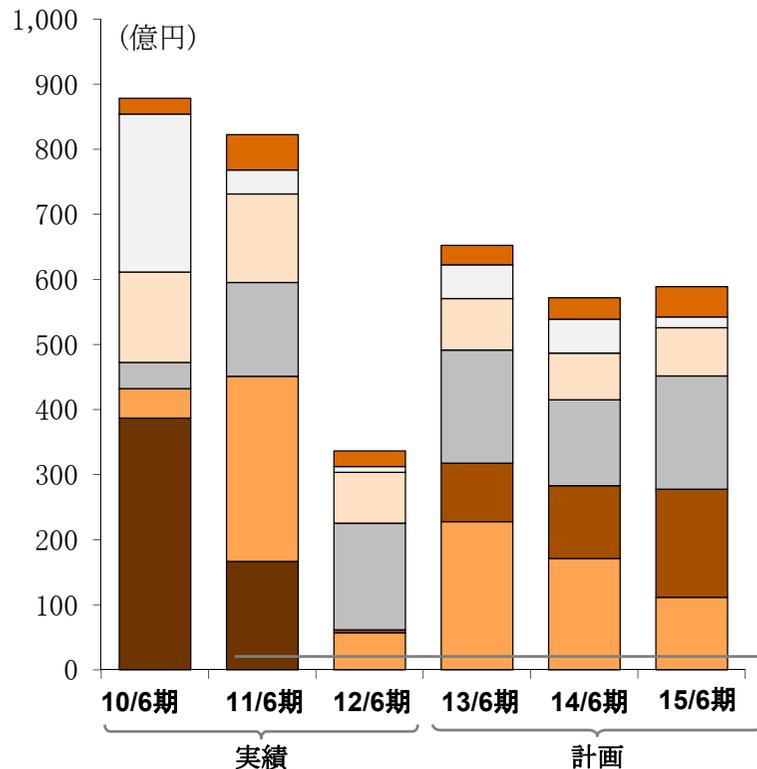
FPD、PV製造装置の受注イメージ

■用途市場別には、IGZOとOLEDが成長の牽引役になると予想

用途市場別受注シナリオ(単体ベース)

トレンド

前提条件



- OLED
- IGZO
- LTPS
- a-Si

PV(太陽電池)

- 投資が一巡。主要顧客の工場新設に伴う受注が主

OLED

- 薄膜封止装置、OLED製造装置の領域で、韓国メーカーに追従する中国・台湾メーカーからの受注を見込む

IGZO

- 新規ラインは、a-Si投資を計画していた中国メーカーを中心に受注獲得。
- スパッタ工程の改造で、既存のa-SiラインでIGZO製造が可能。主要メーカーからの改造を見込む

LTPS

- 11/6期、12/6期の韓国日本の先進メーカーに追従する台湾、日本のメーカーからの設備投資受注を見込む

a-Si

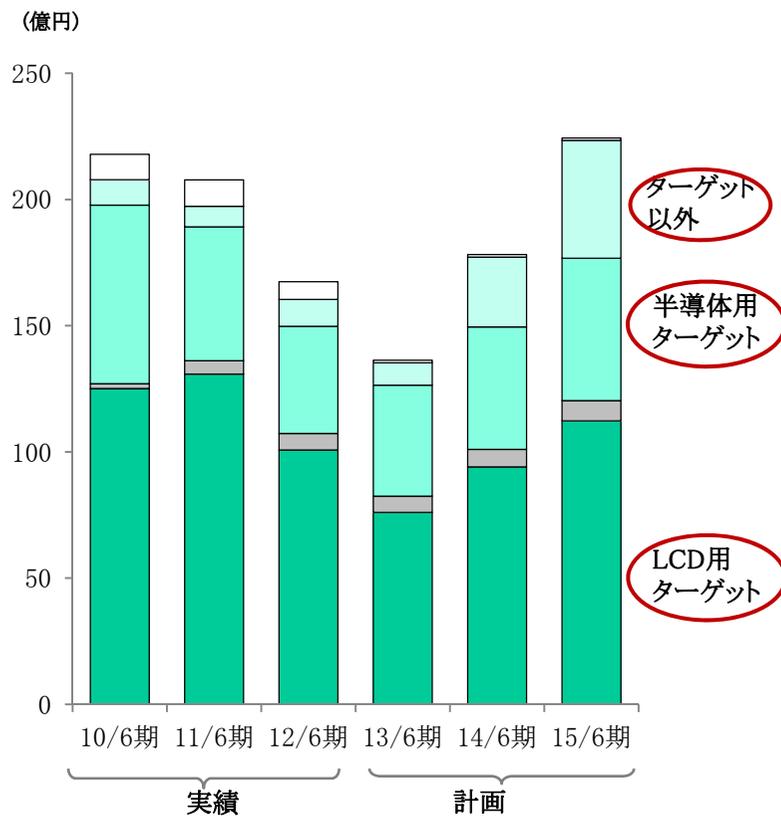
- 大型LCD向け投資の一巡を受けて、LCD新規ライン製造の計画に伴う受注を見込まず

注)上記予想数値は、あくまでも中期の予想をイメージしたもので確約された数値ではありません。

マテリアル事業の受注イメージ

■用途市場別では、半導体とIGZOターゲットの成長に期待。

用途市場別受注シナリオ(単体ベース)



トレンド

前提条件

半導体用ターゲット

- 従来型の貴金属から、焼結タングステンや薄膜リチウムイオン等の新規素材へのシフトを見込む

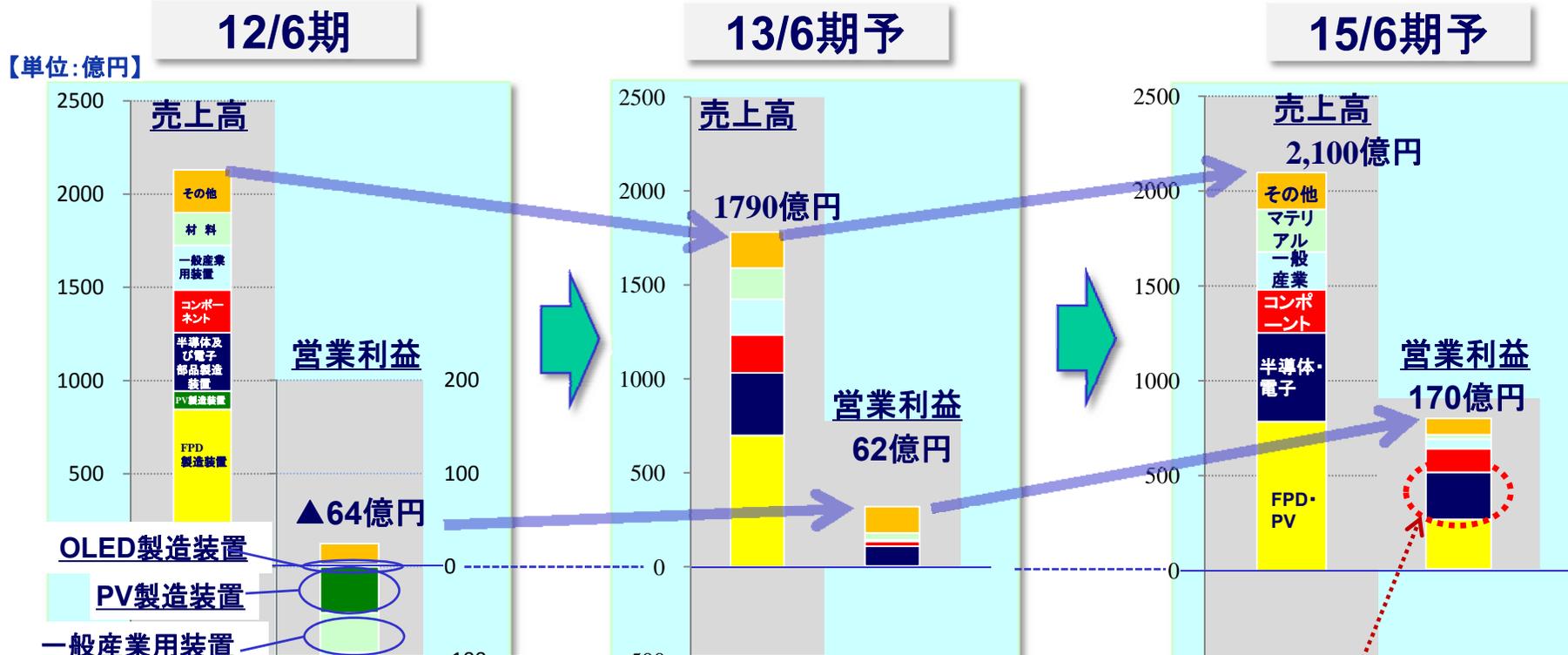
LCD用ターゲット(IGZO)

- モバイル・タブレット高精細化、OLED TV駆動用、大型TVの2K4K化により市場は拡大する見通し
- 主要各社(LCD業界上位5社)の評価で先行中であり、2社では量産採用決定済
- 当社は装置、プロセスとの連携で各社開発・試作向けをほぼ掌握済で、13/6期からの導入確実
- 14/6期以降は、IGZOパネル面積成長率に連動

注)上記予想数値は、あくまでも中期の予想をイメージしたもので確約された数値ではありません。

13/6期以降の営業利益の予想イメージ

■13/6期以降の収益は、前期に発生した一過性の追加原価の収束及び構造改革効果により、回復に向かう。



- ・OLED関連、一般産業用装置の追加原価は収束に向かう。
- ・PVは絞り込み(商品の絞り込み、在庫処理等)が終了

- ・収益性の高い、半導体・電子部品製造装置が収益を牽引。

注)上記予想数値は、あくまでも中期の予想をイメージしたもので確約された数値ではありません。

真空テクノロジーで
「つくる」をつくる、アルバック
ULVAC

本日は
ありがとうございました

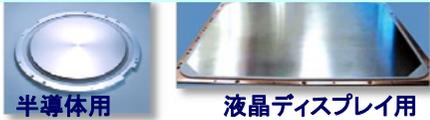
会社概要(2012年6月期)

その他
(表面分析装置、制御システム、委託成膜等)



熱電特性評価装置 X線光電子分光分析装置

材料・部材
(スパッタターゲット材、先端材料等)



半導体用 液晶ディスプレイ用

一般産業用装置
(真空熱処理炉等一般産業機器製造装置)



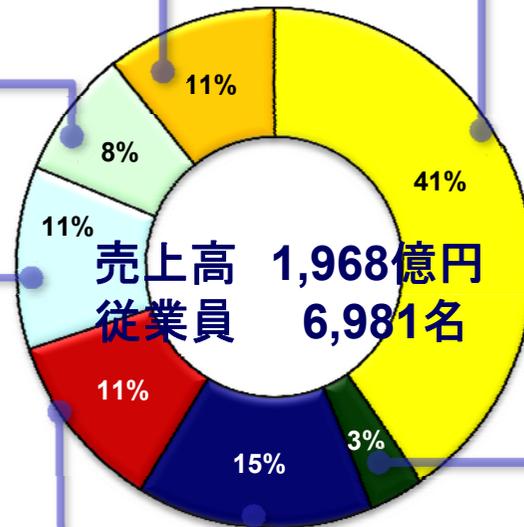
μパウダードライ 希土類磁石製造装置

コンポーネント
(真空ポンプ、計測器、電源等の真空機器)

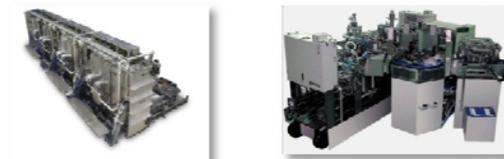


ガス分析計 分光エリブソメーター ドライポンプ

■ 真空機器事業
■ 真空応用事業



FPD製造装置
(液晶、有機EL、PDP等製造装置)



スパッタリング装置 OLED製造装置

PV製造装置
(太陽電池(薄膜、結晶、化合物系等)製造装置)



イオン注入装置 スパッタリング装置

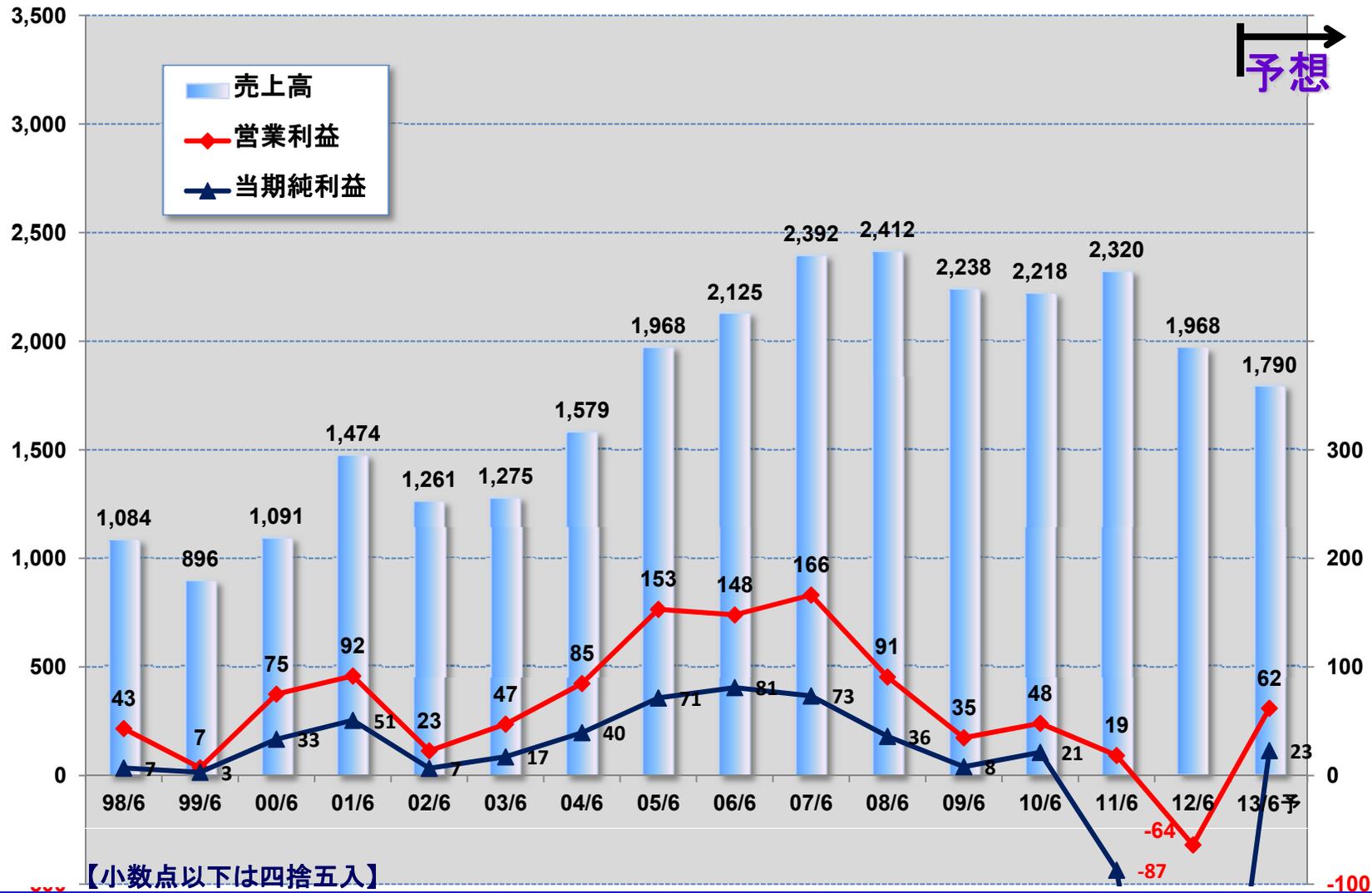
半導体及び電子部品製造装置
(メモリー、LED、電子部品等の製造装置)



エッチング装置 ITOスパッタリング装置 メモリ用スパ何リング装置

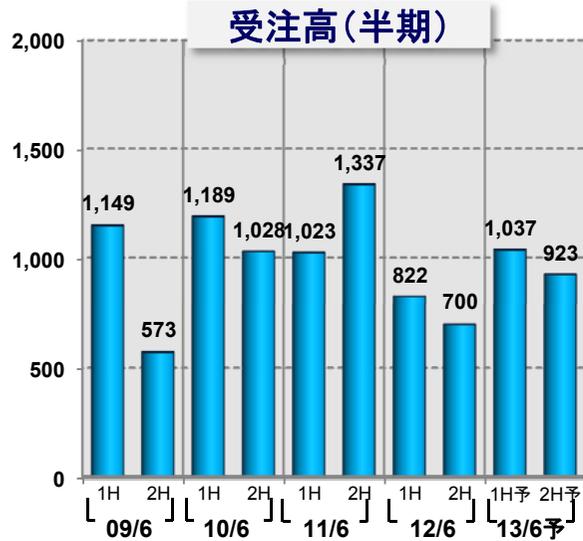
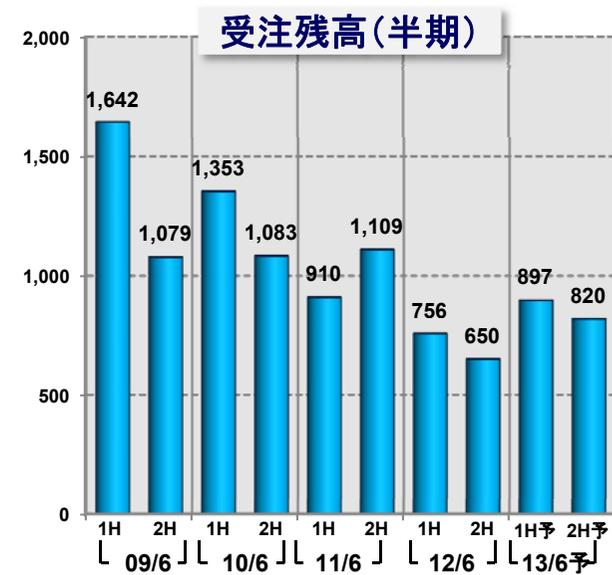
売上高と利益の推移・予想

【単位：億円】



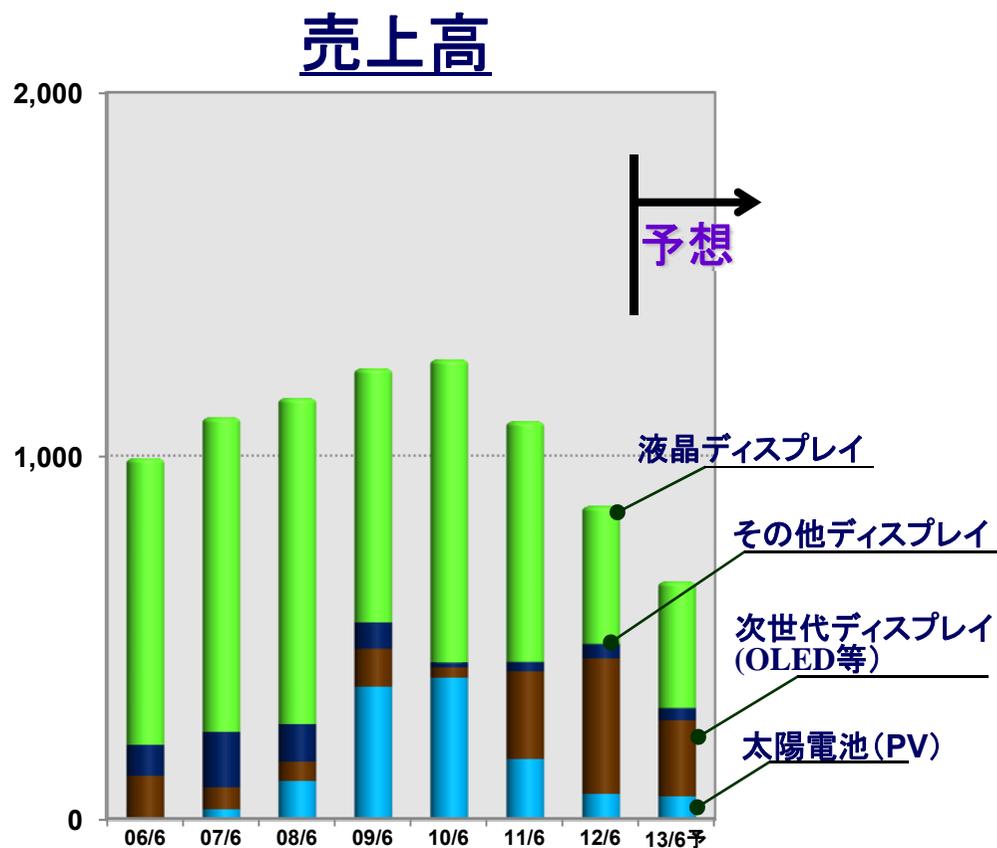
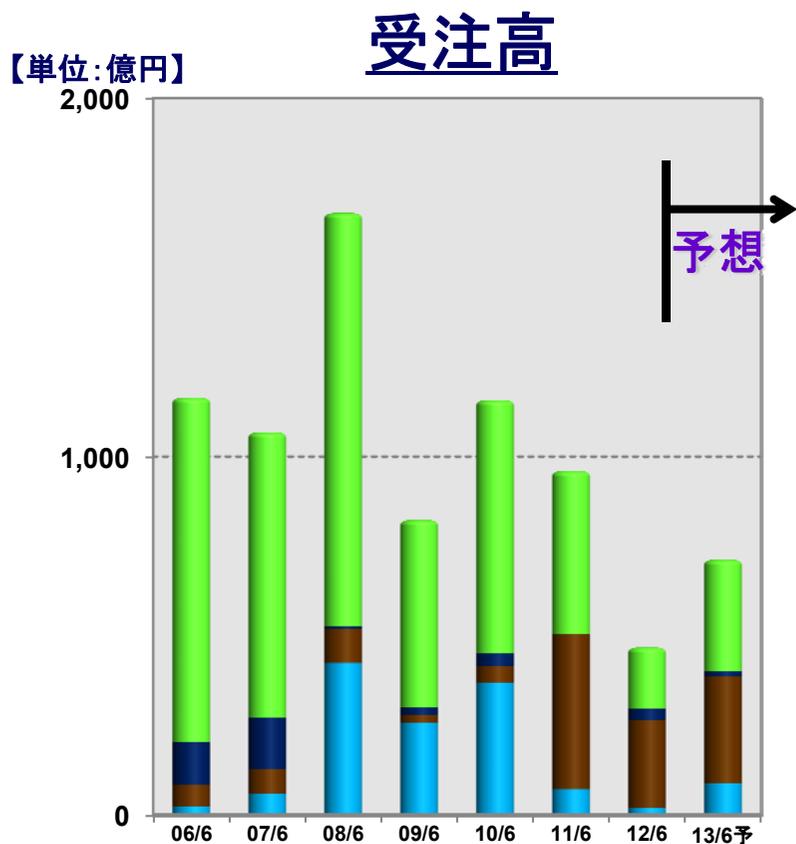
受注高・売上高・受注残高の推移・予想

【単位：億円】



【小数点以下は四捨五入】

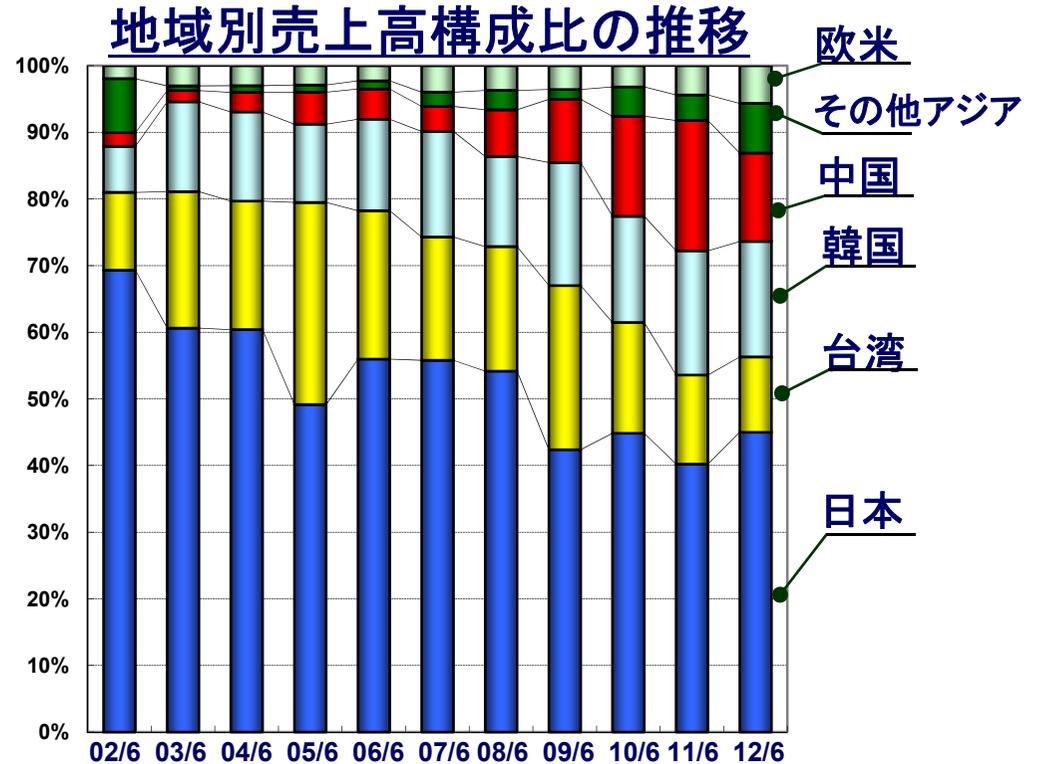
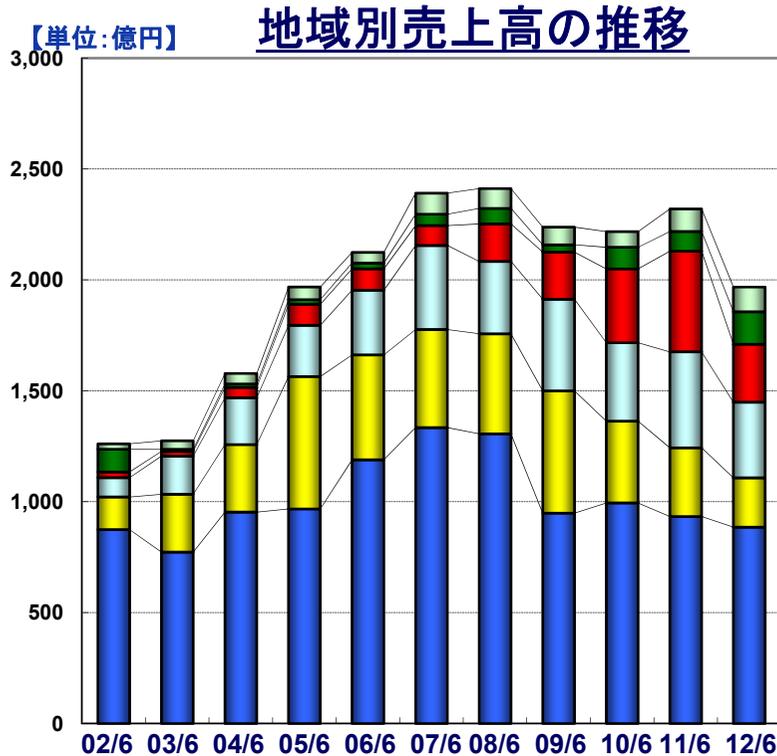
FPD製造装置・PV製造装置の推移・予想



足元の受注環境

- ◆大型液晶ディスプレイは、全般的に低迷。
- ◆中小型液晶のLTPS(低温ポリシリコン)やOLEDの引合い、受注が日本、中国を中心に。
- ◆有機EL照明の引合いが増加。

地域別売上高の推移

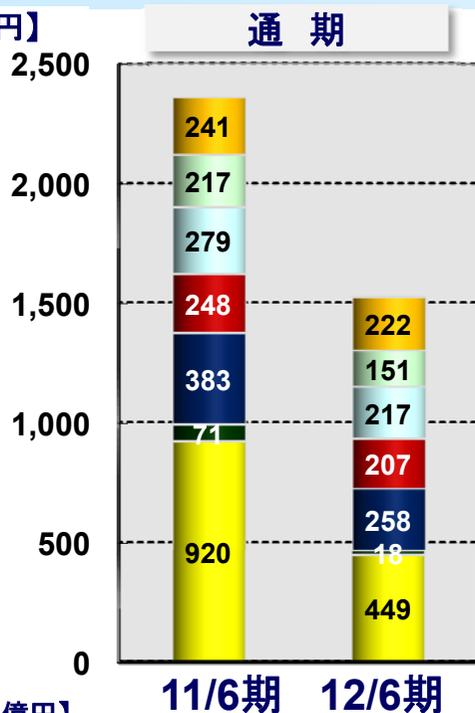


	02/6		03/6		04/6		05/6		06/6		07/6		08/6		09/6		10/6		11/6		12/6		
	売上高	比率	前期比																				
日本	874	69%	773	61%	953	60%	968	49%	1,189	56%	1,334	56%	1,307	54%	949	42%	995	45%	933	40%	886	45%	-5%
台湾	147	12%	261	20%	304	19%	597	30%	473	22%	442	18%	451	19%	551	25%	369	17%	310	13%	223	11%	-28%
韓国	87	7%	172	13%	211	13%	231	12%	292	14%	379	16%	326	14%	413	18%	354	16%	433	19%	341	17%	-21%
中国	26	2%	22	2%	47	3%	94	5%	96	5%	90	4%	169	7%	212	9%	333	15%	454	20%	260	13%	-43%
その他アジア	102	8%	9	1%	16	1%	21	1%	26	1%	51	2%	70	3%	33	1%	96	4%	89	4%	147	8%	65%
欧米	24	2%	38	3%	47	3%	57	3%	48	2%	95	4%	89	4%	80	4%	72	3%	102	4%	111	6%	9%
合計	1,261	100%	1,275	100%	1,579	100%	1,968	100%	2,125	100%	2,392	100%	2,412	100%	2,238	100%	2,218	100%	2,320	100%	1,968	100%	-15%

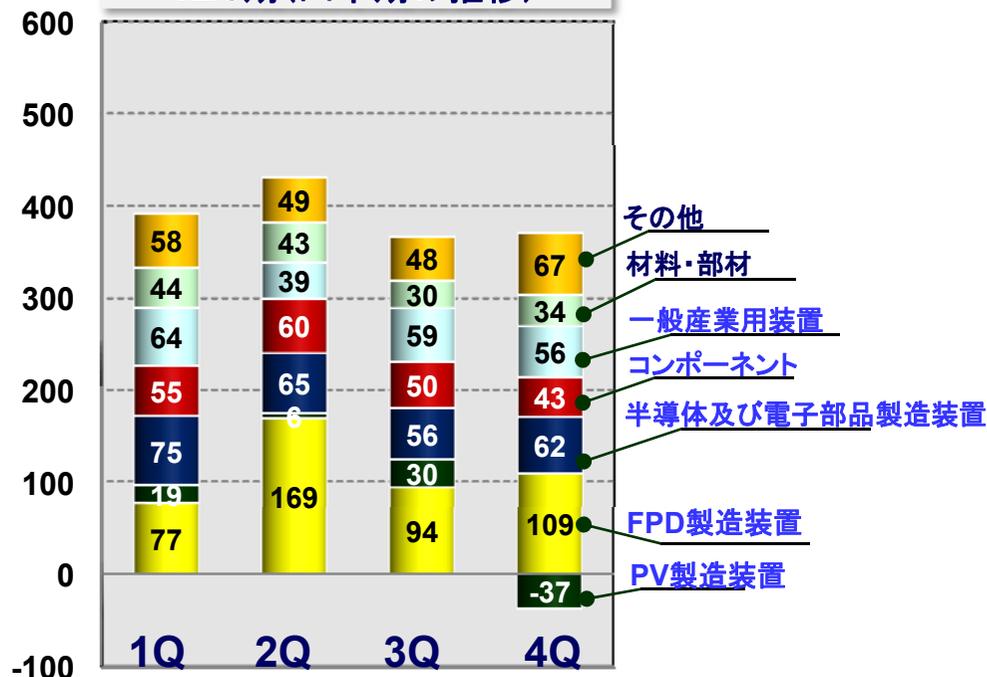
【百万円単位で計算後、単位未満四捨五入】

品目別受注高の実績

【単位:億円】



12/6期(四半期の推移)



【単位:億円】

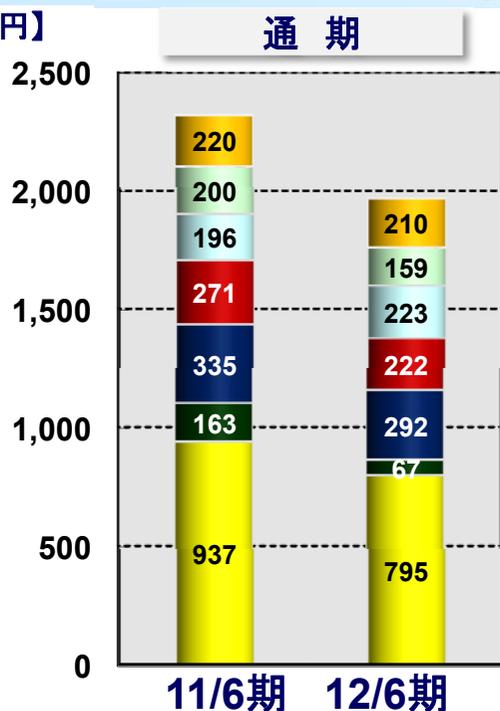
セグメント	11/6期		12/6期		前年同期比 (増減率)
	受注高	構成比	受注高	構成比	
真空機器事業	1,901	80.6%	1,149	75.5%	-39.5%
FPD製造装置	920	39.0%	449	29.5%	-51.2%
PV製造装置	71	3.0%	18	1.2%	-74.9%
半導体及び電子部品製造装置	383	16.2%	258	17.0%	-32.5%
コンポーネント	248	10.5%	207	13.6%	-16.4%
一般産業用装置	279	11.8%	217	14.2%	-22.4%
真空応用事業	459	19.4%	373	24.5%	-18.6%
材料・部材	217	9.2%	151	9.9%	-30.5%
その他	241	10.2%	222	14.6%	-7.9%
合計	2,359	100.0%	1,522	100.0%	-35.5%

セグメント	1Q		2Q		3Q		4Q	
	受注高	構成比	受注高	構成比	受注高	構成比	受注高	構成比
真空機器事業	290	74.0%	338	78.5%	289	78.8%	232	69.7%
FPD製造装置	77	19.7%	169	39.1%	94	25.6%	109	32.8%
PV製造装置	19	4.9%	6	1.3%	30	8.2%	-37	-11.2%
半導体及び電子部品製造装置	75	19.2%	65	15.2%	56	15.4%	62	18.5%
コンポーネント	55	14.0%	60	13.9%	50	13.6%	43	12.9%
一般産業用装置	64	16.2%	39	9.0%	59	16.0%	56	16.7%
真空応用事業	102	26.0%	93	21.5%	78	21.2%	101	30.3%
材料・部材	44	11.2%	43	10.1%	30	8.2%	34	10.2%
その他	58	14.8%	49	11.4%	48	13.0%	67	20.2%
合計	391	100.0%	431	100.0%	367	100.0%	333	100.0%

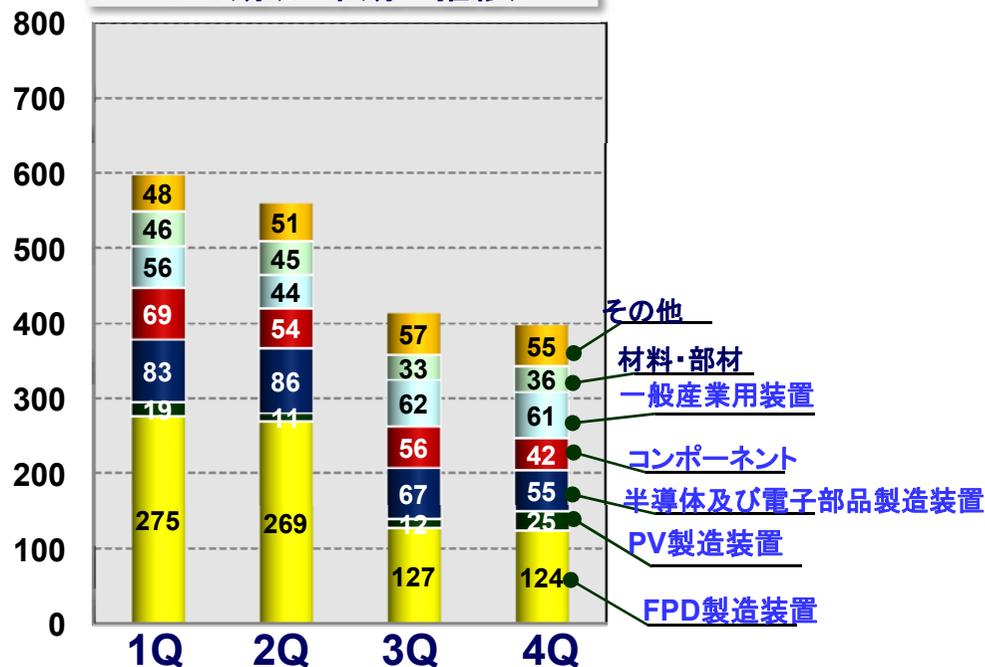
【記載された金額は四捨五入しておりますので各項目の合計値が一致しない場合があります。】

品目別売上高の実績

【単位:億円】



12/6期(四半期の推移)

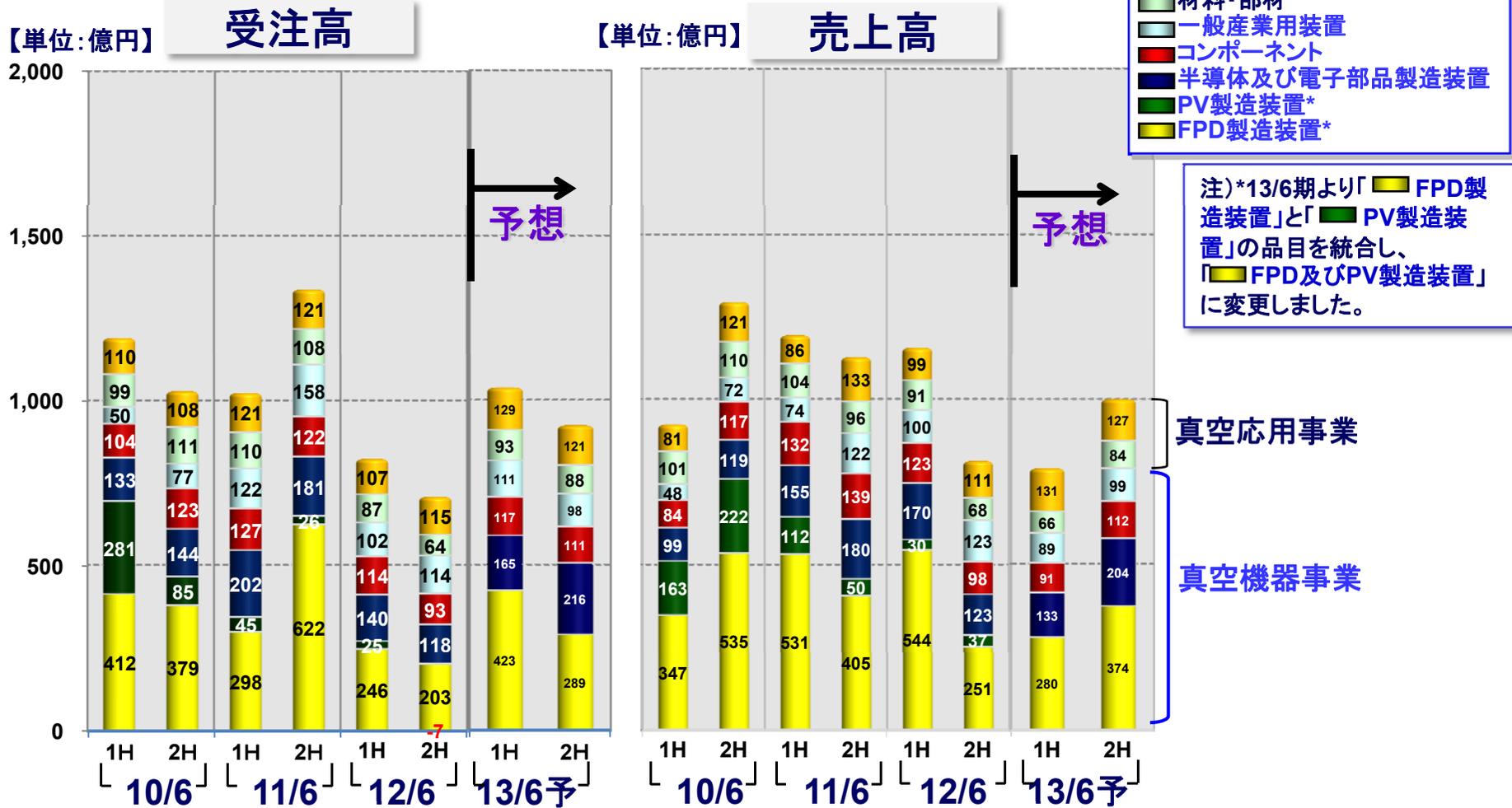


【単位:億円】

セグメント	11/6期		12/6期		前年同期比 (増減率)	セグメント	1Q		2Q		3Q		4Q	
	売上高	構成比	売上高	構成比			売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比
真空機器事業	1,900	81.9%	1,599	81.2%	-15.1%	真空機器事業	503	84.3%	464	82.9%	324	78.4%	308	77.3%
FPD製造装置	937	40.4%	795	40.4%	-15.1%	FPD製造装置	275	46.1%	269	48.1%	127	30.7%	124	31.2%
PV製造装置	163	7.0%	67	3.4%	-58.8%	PV製造装置	19	3.2%	11	2.0%	12	2.9%	25	6.3%
半導体及び電子部品製造装置	335	14.4%	292	14.9%	-12.7%	半導体及び電子部品製造装置	83	14.0%	86	15.4%	67	16.3%	55	13.9%
コンポーネント	271	11.7%	222	11.3%	-18.1%	コンポーネント	69	11.6%	54	9.7%	56	13.6%	42	10.6%
一般産業用装置	196	8.4%	223	11.3%	13.8%	一般産業用装置	56	9.4%	44	7.8%	62	14.9%	61	15.4%
真空応用事業	420	18.1%	369	18.8%	-12.1%	真空応用事業	94	15.7%	96	17.1%	89	21.6%	90	22.7%
材料・部材	200	8.6%	159	8.1%	-20.7%	材料・部材	46	7.6%	45	8.0%	33	7.9%	36	8.9%
その他	220	9.5%	210	10.7%	-4.3%	その他	48	8.1%	51	9.1%	57	13.7%	55	13.7%
合計	2,320	100.0%	1,968	100.0%	-15.2%	合計	597	100.0%	560	100.0%	414	100.0%	398	100.0%

【記載された金額は四捨五入しておりますので各項目の合計値が一致しない場合があります。】

品目別受注高/売上高推移・予想(半期)



【記載された金額は四捨五入しておりますので各項目の合計値が一致しない場合があります。】

真空テクノロジーで /
「つくる」をつくる、アルバック

ULVAC